

詞彙表

本技術詞彙載有本文件所用與本公司及我們的業務有關的若干技術詞彙的釋義。該等術語及涵義未必與行業標準涵義或該等詞彙的用法一致。

「3C」	指	電腦、通訊和消費電子產品的簡稱；在本文件中，一般指使用PCB及精密加工配件的手機、平板電腦及相關設備等消費電子產品。
「AGV」	指	自動導引車，為一種自主物料搬運車輛，用於我們的自動化存取系統，以進行倉庫和生產設施中的線邊倉儲、出入庫操作及庫存盤點。
「AI」	指	人工智能，為使機器和系統能夠執行通常需要人類智能的任務的技術，例如感知、模式識別、預測或決策。
「AI基建」	指	數據中心、AI服務器、高速網絡和儲存系統以及相關硬件和軟件的組合，支援AI模型和AI賦能的應用程序的訓練和推理。
「AI服務器」	指	經配置處理器、加速器及記憶子系統的服務器，針對AI工作負載(包括用於數據中心及雲端平台等機器學習模型的訓練及推理)進行優化。
「背鑽(工藝)」	指	一種從PCB的另一側鑽出部分電鍍通孔的工藝。
「年複合增長率」	指	年複合增長率，指某一數量(例如市場規模或收入)在超過一年的特定期間內的平均年增長率。
「硬質合金」	指	一種堅硬、耐磨的複合材料，通常由碳化鎢顆粒與金屬黏合劑(例如鈷)結合而成，廣泛用於製造鑽針、銑刀和數控刀具。

詞彙表

「陶瓷磨刷」、「不織布磨刷」及「尼龍磨刷」	指	用於PCB製造的研磨拋光刷類型，按其刷介質(陶瓷、不織布或尼龍)區分，用於去除鑽針毛刺和樹脂污漬、平整銅表面及清潔微孔。
「數控」	指	電腦數控，為對機床進行電腦化控制，其中執行預編程序的機床控制命令序列以執行自動化加工操作。
「數控刀具」	指	安裝在數控機床上的切削和成形工具(包括(其中包括)金剛石工具、銑刀、鉸刀、絲錐和可轉位刀片)，用於對金屬和複合材料進行銑削、車削、鑽孔及相關操作。
「塗層技術」	指	鑽針、銑刀及其他工具的工作表面塗有薄膜，例如CVD金剛石、物理氣相沉積耐(PVD)磨塗層或四面體非晶碳(ta-C)塗層，以提高耐磨性、減少摩擦並延長工具壽命和鑽針性能。
「CVD金剛石塗層」	指	一種通過化學氣相沉積在工具表面形成的薄金剛石層，用於在加工陶瓷和鋁基基板等硬質或磨蝕性材料時，大幅提高耐磨性。
「鑽針」	指	一種用於鑽孔的細長旋轉切削工具。在PCB製造中，鑽針用於製造微孔及其他孔洞，以形成PCB板層之間的電氣互連。
「具身機器人」	指	AI賦能機器人(以硬件形式實體化，例如工業或服務機器人)，與實體環境互動，需要整合機械、驅動、控制和感應系統；我們的產品支援(其中包括)此類機器人所用的驅動配件和精密加工零件等。
「FCBGA」	指	覆晶球柵陣列，一種先進的半導體封裝類型，其中芯片被翻轉並通過焊料凸塊連接到基板，焊球以柵格陣列形式排列在基板底部；用於高性能計算、網絡和AI基建。

詞彙表

「FC-CSP」	指	覆晶芯片級封裝，一種緊湊型半導體封裝格式，其中芯片通過覆晶芯片互連直接連接到基板上，整體尺寸不比芯片本身大很多；用於對基板平整度和表面質量要求嚴格的高密度、高性能應用。
「功能性膜材料」	指	薄膜，通常應用於玻璃或聚合物基板，為包括背光模組、下偏光片、蓋板玻璃及車載顯示器(特別是智能汽車)在內的應用提供光學、保護或功能特性(如光線控制、防眩光、抗反射或耐刮擦)。
「研磨拋光材料」	指	用於PCB製造的消耗性研磨產品(例如刷磨輪及其他研磨拋光介質)，以去除毛刺和樹脂污漬、平整銅表面、清潔微孔以及為後續電鍍、塞孔和電路形成工藝準備PCB。
「高密度互連」	指	高密度互連，一種以細線路、小通孔、高連接焊盤密度和薄介電層為特徵的PCB，常用於智能手機、AI服務器和高端計算設備等先進電子產品中。
「高長徑比孔」	指	孔的長徑比相對較大，使鑽針和隨後的金屬化更困難；此類孔在高層數PCB、封裝基板和高性能計算板中為常見。
「高性能計算」	指	高性能計算，即利用大規模計算資源(包括AI服務器和網絡設備)高速處理複雜任務和大量數據。
「集成電路」	指	集成電路，一種在小型半導體芯片上形成的電子電路，包含多個電子元件，例如電晶體和電阻器，廣泛用於各種電子設備和系統。
「封裝基板」	指	一種高密度互連基板，用於在封裝(例如FCBGA)中安裝和互連集成電路；封裝基板在半導體芯片和PCB之間提供精細佈線、熱管理和機械支撐。

詞彙表

「智能數控裝備」	指	我們的高精密數控刀具磨床和階梯圓柱磨床以及其他設備，結合了多軸數控控制、自動化、感應和閉環過程優化，以支援鑽針、銑刀和其他精密刀具的製造和再研磨。
「低軌衛星通信」	指	透過在低地球軌道運行的衛星(通常在數百至約2,000公里高度)提供的通訊服務，用於寬頻連接及其他應用，並帶動對高性能PCB及相關工具的需求。
「金屬基板」	指	金屬基印刷電路板，一種利用金屬(通常為鋁或銅)核心以改善散熱的PCB，常應用於LED照明和電力電子等大功率或高散熱要求的應用中。
「微孔」	指	PCB中的小直徑孔，通常通過機械或激光鑽針形成，用於連接PCB的一層與相鄰層，是高密度互連PCB結構的核心。
「PCB」	指	印刷電路板，一種由絕緣材料和銅層製成的層壓板，用於通過導電軌跡、焊盤和其他特徵，機械支撐和電氣連接電子元件。
「PCB刀具」	指	用於PCB製造的專用切削及路徑工具，包括鑽針、銑刀、斜角(金手指)刀具、倒角刀具、埋頭鑽、雕刻/V形鑽頭、鍵槽/T形槽刀具及其他成形工具。
「物理氣相沉積塗層」	指	通過物理氣相沉積形成的塗層，其中將耐磨材料的薄膜沉積在真空環境中的刀具表面上，用於減少刀具磨損、提高鑽針性能和延長刀具壽命。

詞彙表

「四面體非晶碳」	指	四面體非晶碳，一種具有高硬度和低摩擦的碳基塗層，用於鑽針和其他刀具，以減少磨損並減輕高長徑比孔中的內部銅屑和切屑堵塞等問題。
「VMI」	指	供應商管理庫存，即供應商管理客戶現場或其附近（通常使用VMI倉庫）的庫存水平，並在客戶根據協定對賬週期提取庫存時確認收入的供應鏈安排。